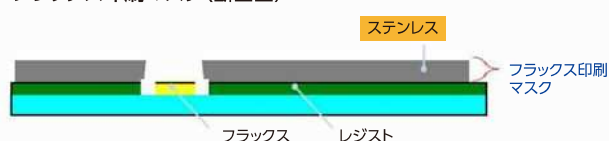


マイクロ半田ボール配列用メタルマスク

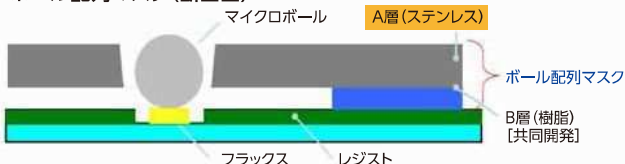
- 基板と半導体パッケージの接続に必要な半田バンプ形成に使用される半田ボール配列用のマスクです。
- マイクロ半田ボールは従来の半田ペースト印刷によるバンプ形成より、より高密度で高さの均一性を要求される際に使われ、配列用マスク及びフラックス印刷用にも精度が要求されます。

アサヒテック サブストレート用 ボール配列マスク・フラックス印刷マスクの構造

フラックス印刷マスク (断面図)



ボール配列マスク (断面図)



アサヒテック ボール配列マスクの特徴

方法	特徴
フラックス印刷用	耐久性に非常に優れております。 高テンションで作成することが可能。 板厚精度、ピッチ精度に優れております。 板厚20μm対応可。試作では10μmも実績がございます。
ボール配列用	2層構造になっております。 B層は基板との密着性が高い。 B層のデザインによっては、更に密着性を増すことも可能です。

アサヒテック ボール配列マスクの仕様

方法	特徴
フラックス印刷用	開口寸法: $\pm 3\mu\text{m}$ ピッチ: $\pm 20\mu\text{m}$ A層厚み: 20μm / 30μm / 40μm / 50μm / 60μm / 70μm / 80μm ($\pm 5\%$ [Min: 2μm])
ボール配列用	開口寸法: $\pm 3\mu\text{m}$ ピッチ: $\pm 20\mu\text{m}$ A層厚み: 20μm / 30μm / 40μm / 50μm / 60μm / 70μm / 80μm ($\pm 5\%$ [Min: 2μm]) B層厚み: 10μm~60μm[任意] ($\pm 5\mu\text{m}$) A層・B層 位置合わせ精度: $\pm 0.3\text{mm}$ (B層パターンサイズ精度含む)

アサヒテック ボール配列マスクの用途

半田ボール搭載

